

平成 25 年 10 月 7 日

各 位

会社名 シャープ株式会社
代表者名 取締役社長 高橋 興三
(コード番号 6753)
問合せ先 広報部長 武浪 裕
TEL 大阪 (06)6621-1272
東京 (03)5446-8205

株式会社デンソーに対する第三者割当による
新株式発行に係る発行条件等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 9 月 18 日開催の取締役会において決議いたしました株式会社デンソー（以下「デンソー」という。）を割当先とした第三者割当による新株式の発行（以下「本件第三者割当増資」という。）につきまして、平成 25 年 10 月 7 日開催の取締役会にて発行価額及び発行新株式数等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。デンソーを割当先とした第三者割当による新株式の発行に関して、平成 25 年 9 月 18 日のプレスリリースにおいてお知らせしておりましたが、今回発行条件等を改めて決定したものです。

なお、当社は、平成 25 年 9 月 18 日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の日本国内における募集（以下「国内一般募集」という。）、海外市場における募集（以下「海外募集」という。国内一般募集及び海外募集を総称して、以下「本件公募」という。）及び本件公募に伴う当社普通株式の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）に関連して行われる第三者割当増資（以下「OA 第三者割当増資」という。）に係る発行価格及び売出価格等、並びに株式会社マキタを割当先とする第三者割当増資（以下「マキタ第三者割当増資」という。）及び株式会社 L I X I L を割当先とする第三者割当増資（以下「L I X I L 第三者割当増資」という。）に係る発行価額及び発行新株式数等についても決定しておりますが、それぞれの詳細につきましては、本日別途公表しております「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」、「株式会社マキタに対する第三者割当による新株式発行に係る発行条件等の決定に関するお知らせ」及び「株式会社 L I X I L に対する第三者割当による新株式発行に係る発行条件等の決定に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 募集の概要

① 払 込 期 日	平成 25 年 10 月 22 日 (火)
② 発 行 新 株 式 数	8,960,000 株
③ 発 行 価 額	1 株につき 279 円 (注)
④ 調 達 資 金 の 額	2,499,840,000 円
⑤ 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 予 定 先)	第三者割当の方法によります。 (株式会社デンソー 8,960,000 株)
⑥ そ の 他	※上記各号については、金融商品取引法に基づく本件第三者割当増資に係る有価証券届出書及び当該有価証券届出書の訂正届出書の効力発生を条件とします。

(注) 国内一般募集による新株式発行における発行価格（募集価格）と同一の金額です。

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。

2. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

① 払込金額の総額	2,499,840,000円
② 発行諸費用の概算額	22,000,000円
③ 差引手取概算額	2,477,840,000円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用(約9百万円)、弁護士費用(約7百万円)、取引所上場関係費用(約3百万円)及びその他(約3百万円)です。

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額2,478百万円の具体的な使途については、次のとおり予定しております。

具体的な使途	金額	支出予定時期
車載事業分野における協業推進のための専門組織の立ち上げ及び活動費等を含む事業運営資金	2,478百万円	平成25年9月～ 平成27年8月

デンソーが培った車載機器技術に、当社が家電開発で培った先端技術をユーザー志向で融合させることにより、新たな事業の立ち上げ(これらのための共同開発と商品開発を含む。)を目指してまいります。これは、平成25年5月14日に公表した「2013～2015年度中期経営計画」で掲げた重点事業領域のうちモビリティにおける新規事業の取り組みの一環であり、デンソー及び当社の企業価値の向上及び持続的な成長に資するものと考えております。

3. 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本件第三者割当増資により本割当予定先に対して割り当てる予定の当社普通株式の数量8,960,000株(注)1は、平成25年9月17日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,188,491,887株から、平成25年3月28日にサムスン電子ジャパン株式会社(以下「サムスン電子ジャパン」という。)を割当先とする第三者割当増資(以下「サムスン電子ジャパン第三者割当増資」という。)によりサムスン電子ジャパンに対して発行した当社普通株式の数量35,804,000株及び平成25年6月24日にQualcomm Incorporated(以下「Qualcomm」という。)を割当先とする第三者割当増資(以下「Qualcomm第2次第三者割当増資」という。)によりQualcommに対して発行した当社普通株式の数量11,868,000株を除いた1,140,819,887株(以下「第三者割当増資前発行済株式総数」という。)に対して0.79%(議決権総数1,125,054個(注)2)に対する割合0.80%)となります。

なお、本件第三者割当増資、マキタ第三者割当増資及びLIXIL第三者割当増資により割り当てる予定の当社普通株式並びに当初取締役会決議日である平成25年9月18日を基準として最近6か月間に実施したQualcomm第2次第三者割当増資及びサムスン電子ジャパン第三者割当増資により発行した当社普通株式の合計数は110,395,000株となり、第三者割当増資前発行済株式総数である1,140,819,887株に対して9.68%(議決権総数1,125,054個(注)2)に対する割合9.81%)となります。

しかしながら、平成25年9月18日付「株式会社デンソーとの協業に向けた第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」における「II. 第三者割当による新株式の発行 2. 募集の目的及び理由」及び前記「2.

(2) 調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、本件第三者割当増資により調達する資金は、自動車部品メーカートップのデンソーが培った車載機器技術に、当社が家電開発で培った先端技術をユーザー志向で融合させることにより、新たな事業の立ち上げ(これらのための共同開発と商品開発を含む。)を目指すことに充当することで、当社の企業価値の向上及び持続的な成長に資するものであります。こうしたことから、本件第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模、また、本件第三者割当増資、マキタ第三者割当増資及びLIXIL第三者割当増資並びにQualcomm第2次第三者割当増資及びサムスン電子ジャパン第三者割当増資による発行数量の合計及び株式の希薄化の規模は、合理的であると判断しております。

ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。

- (注) 1. 平成 25 年 10 月 7 日開催の会社法第 199 条第 1 項で求められる取締役会決議により決定しております。
2. 議決権総数は発行済株式総数 1,188,491,887 株から、平成 25 年 3 月 31 日時点の株主名簿に基づく単元未満株式 5,291,887 株、自己保有株式（単元未満株式を除く。）10,399,000 株及び相互保有株式 75,000 株並びにサムスン電子ジャパン第三者割当増資によりサムスン電子ジャパンに対して発行した当社普通株式の数量 35,804,000 株及び Qualcomm 第 2 次第三者割当増資により Qualcomm に対して発行した当社普通株式の数量 11,868,000 株を控除して算出したものです。

4. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成 25 年 8 月 31 日現在）		募集後	
日本生命保険相互会社	4.68%	日本生命保険相互会社	3.27%
明治安田生命保険相互会社	3.85%	明治安田生命保険相互会社	2.69%
Qualcomm Incorporated	3.53%	Qualcomm Incorporated	2.47%
株式会社みずほ銀行	3.53%	株式会社みずほ銀行	2.46%
株式会社三菱東京UFJ銀行	3.51%	株式会社三菱東京UFJ銀行	2.45%
サムスン電子ジャパン株式会社	3.01%	株式会社マキタ	2.11%
三井住友海上火災保険株式会社	2.58%	サムスン電子ジャパン株式会社	2.10%
シャープ従業員持株会	2.17%	三井住友海上火災保険株式会社	1.80%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1.92%	シャープ従業員持株会	1.52%
株式会社損害保険ジャパン	1.81%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1.34%

- (注) 1. 平成 25 年 7 月 1 日付にて、旧株式会社みずほ銀行と旧株式会社みずほコーポレート銀行が合併し、吸収合併存続会社である旧株式会社みずほコーポレート銀行は「株式会社みずほ銀行」に商号変更しており、また、平成 25 年 3 月 31 日現在の株主名簿において旧株式会社みずほ銀行名義の所有株式数はないことから、上記株式会社みずほ銀行の募集前後の持株比率については、同株主名簿記載の旧株式会社みずほコーポレート銀行の所有株式数を基準に算定しております。
2. 募集前の持株比率については、平成 25 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として、Qualcomm 第 2 次第三者割当増資による発行株式数を加算の上、算出したものを記載しており、募集後の持株比率については、同株主名簿を基準として、Qualcomm 第 2 次第三者割当増資による発行株式数を加算し、かつ、本件公募、本件第三者割当増資、マキタ第三者割当増資及びLIXIL第三者割当増資による増加分を加味し、野村証券株式会社に対するOA第三者割当増資に対する申込みが全て行われた場合の数字であります。
3. 募集前後の持株比率は小数点以下第三位を四捨五入しております。

ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。

5. 発行要項

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 8,960,000 株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき279円(注)1 |
| (3) 払込金額の総額 | 2,499,840,000円 |
| (4) 増加する資本金の額 | 1,249,920,000円(注)2 |
| (5) 増加する資本準備金の額 | 1,249,920,000円(注)2 |
| (6) 募集又は割当方法
(割当予定先及び
割当予定株数) | 第三者割当の方法によります。
(株式会社デンソー 8,960,000株) |
| (7) 払込期日 | 平成25年10月22日(火) |
| (8) その他 | ※金融商品取引法に基づく本件第三者割当増資に係る有価証券
届出書及び当該有価証券届出書の訂正届出書の効力発生を条
件とします。 |

(注) 1. 国内一般募集による新株式発行における発行価格(募集価格)と同一の金額です。

2. 増加する資本金の額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(払込金額の総額)から増加する資本金の額を減じた額とします。

<ご参考>

本件公募に係る発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	<u>平成25年10月7日(月)</u>	<u>291円</u>
(2) ディスカウント率	<u>4.12%</u>	

以上

ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。